

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2023-045

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于 2023 年第四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时董事会会议于 2023 年 6 月 5 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合电话或视频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配的议案》，以实施分配方案时股权登记日的总股本数 325,281,052 股扣除公司回购专用账户持有股份 2,112,200 股后的股本总额 323,168,852 股为基数，每股派发现金红利 0.187 元（含税）。根据利润分配实施情况，以 2023 年 6 月 1 日为股权登记日，2023 年 6 月 2 日为除权除息日。

鉴于此，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格进行调整。调整后，公司本次激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由 21.9041 元/股调整为 21.7171 元/股。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

关联董事胡世元、蒋卫军回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避，议案通过。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二三年六月六日